

材料与结构评审

适用团队：研发 / 采购 / 质量 / 供应链

工业界面材料选择记录表

用于记录薄膜开关、薄膜面板、硅胶按键和HMI组件中的材料选择依据。表内关注的是材料在具体结构和环境中的作用，不用单一牌号代替样品与整机验证。

项目名称	产品类型
料号	BOM版本
使用环境	目标寿命阶段
记录人员	记录日期

01 面材与外观表面

☐	记录面材类型、厚度、表面纹理、光泽、硬化或其他处理及选择原因。	确认 / 待确认 备注：_____
☐	核对弯折、成型、窗口、按键操作和装配方式对面材的影响。	确认 / 待确认 备注：_____
☐	列出紫外线、清洁剂、酒精、油污、磨耗和刮擦等真实接触条件。	确认 / 待确认 备注：_____
☐	明确颜色、纹理、外观限度和实体签样的版本。	确认 / 待确认 备注：_____

02 油墨、字符与窗口

☐	记录颜色层、白墨、遮光、透明色、导电或其他功能油墨的用途。	确认 / 待确认 备注: _____
☐	确认印刷面、层次顺序、附着基材和需要保护的窗口或透光区域。	确认 / 待确认 备注: _____
☐	窗口材料、透明度、雾度、颜色和表面状态与显示或传感需求相符。	确认 / 待确认 备注: _____
☐	耐磨和化学接触要求采用实际印刷组合与清洁方式评估。	确认 / 待确认 备注: _____

03 背胶、面胶与隔片

☐	记录胶层用途: 永久贴合、可移除、层间粘接、隔离、遮光或密封。	确认 / 待确认 备注: _____
☐	核对贴合基材的材料、表面能、涂层、粗糙度、洁净度和温度。	确认 / 待确认 备注: _____
☐	胶层厚度、开口、连续密封边、排气和离型分片与结构相符。	确认 / 待确认 备注: _____
☐	储存、模切、贴合、等待、返工和老化条件进入工艺与验证计划。	确认 / 待确认 备注: _____

04 线路与导电材料

☐	记录线路基材、导电银浆、碳浆、绝缘层或FPC / PCB方案及使用理由。	确认 / 待确认 备注: _____
☐	导线宽度、间距、弯折、载流、接点和元件焊接条件与材料方案相容。	确认 / 待确认 备注: _____
☐	尾排长度、接触区、补强、连接器和插拔方式已经与接口共同确认。	确认 / 待确认 备注: _____
☐	开短路、接触、电阻或其他电气检验项目有对应的样品和量产方法。	确认 / 待确认 备注: _____

05 触感、硅胶与结构件

☐	记录弹片、硅胶配方、导电粒、塑胶或金属支撑件在组件中的功能。	确认 / 待确认 备注：_____
☐	手感、回弹、接触、支撑、预压和装配压缩通过实际结构样确认。	确认 / 待确认 备注：_____
☐	硅胶字符、喷涂、镭雕、透光和表面涂层与清洁和磨耗场景对应。	确认 / 待确认 备注：_____
☐	金属补强、背板、螺柱、框体和紧固件不会损伤线路或破坏密封路径。	确认 / 待确认 备注：_____

06 供应、变更与批准

☐	关键材料记录制造商、内部料号、供应来源和可接受替代范围。	确认 / 待确认 备注：_____
☐	客户指定料、长交期料和停产风险有备选方案或库存策略。	确认 / 待确认 备注：_____
☐	任何牌号、厚度、颜色、胶系或表面处理变更进入工程评审和重新验证。	确认 / 待确认 备注：_____
☐	批准样、BOM、图纸、材料声明和检验规范保持同一版本。	确认 / 待确认 备注：_____

文件版本	填写日期	填写人	项目确认人

材料选择记录建议附上

- BOM与层结构图
- 材料数据和样品编号
- 实际接触环境
- 替代料与变更边界

东莞市茗智电子科技有限公司
官网：szjasper.com
业务手机：136 3262 5290



工程说明：本资料用于整理项目输入和待确认事项，不替代双方确认的图纸、样件、测试条件、技术协议或订单要求。